

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2026年4月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	财务总监、副总经理金良凯先生 董事会秘书、副总经理李大林先生 研发总监钟磊先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 2025年度及2026年第一季度公司经营情况介绍？</p> <p>2025年全球半导体销售额达到7,917亿美元，同比增长25.6%，创历史新高。从细分领域来看，行业整体发展出现结构性分化，呈现出AI相关需求高速增长、传统应用领域平稳复苏的格局。2025年，公司营业收入逐季环比保持增长，全年实现营业收入439,836.62万元，再创历史新高，同比增长21.87%；实现归属于母公司所有者的净利润8,172.86万元，较上年同期增长23.22%，整体毛利率达到16.64%。2026年第一季度实现营业收入117,215.22万元，同比增长23.97%，环比略有下降，营收规模明显提升；Q1毛利率达到17.51%，同比增长3.32个百分点；期间费用率合计为17.65%，总费用率同比降低2.81个百分点，环比下降0.2个百分</p>

点，去年全年是 18.87%。毛利率改善叠加费用率下降，综合使得利润总额方面，本季度利润总额 2,070.42 万元，同比增加 142.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由亏转盈，相比上年同期增加 2,945.67 万元；自公司二期项目启动以来，公司营收增长与盈利能力持续向好，规模效应逐步体现，目前营业规模已经初步跨过盈亏平衡点，主营业务盈利能力持续增强。

产品结构方面，2025 年度各产品的营收均呈现不同程度的增长，其中晶圆级产品的营收和毛利率都大幅增加，先进封装发展势头良好。SiP 类产品营收占比约 39.88%，QFN 营收占比约为 38.74%，FC 产品营收占比约 16.38%，晶圆级封装营收占比约 4.52%，二者合计占比接近 21%。从应用领域来看，AIoT 占比超过六成，增速超过 20%，PA 和安防各占比约一成，运算和车规产品合计占比 10%左右，其中车规产品增速较快，同比增长达到 121.59%。

客户结构方面，公司坚持客户导向，抢抓战略机遇，2025 年度共有 24 家客户销售额超过 5,000 万元，客户结构进一步优化。受地缘环境影响，全球龙头设计公司基于 China for China 等多方面战略考量，在中国大陆进行产能布局的意愿明显提升，公司抢抓战略机遇，在深耕中国台湾地区客户的基础上，积极拓展欧美客户群体，海外客户营收占比持续提升，达到 23.29%，同比增长 61.40%；从应用领域分析，公司现有核心 AIoT 客户群基本盘稳固，在汽车电子、射频模组等领域的持续布局也实现稳步成长。通过多产品线及多领域布局，公司已经形成了多个业务增长极，为持续发展奠定坚实基础。

新产品布局方面，公司持续加大先进封装投入，打造甬矽特有的 FH-BSAP 先进封装平台，围绕客户提供全方位服务。2025 年公司新增获得授权的发明专利 61 项，实用新型专利 96 项，软件著作权 3 项。公司先进封装产品线客户群稳步扩大，公司重点打造的“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力不断提升，2025 年公司晶圆级封测产品贡献营业收入 19,548.42 万元，同比增长 84.22%，有效客户群持续扩大，量产规模稳步爬升，贡献了新的营收增长点。扇出式封装（Fan-out）及 2.5D/3D 封装工艺，相关产品线均已实现通线，基于硅转接板和硅桥方案的 2.5D 产品均实现客户送样，目前正在与部分客户进行产品验证。公司自身技术水平和客户服务能力得到显著提升。

2. 2026 年主要业务增长点？

首先是现有核心客户的成长，公司身为国内头部端侧 SoC 客户的核心供应商，承接了较多的新品开发项目，会伴随其业务量一同成长；其次是海外客户持续拓展，海外客户一方面基于 China for China 战略，产能向大陆溢出意愿明显，另一方面中国台湾地区头部封测企业因 AI 相关需求持续旺盛，将消费类封装产能转向 AI/HPC 等产品，导致消费类电子订单外溢，预计未来海外客户营收增速将高于公司整体平均水平；最后是 AI 相关先进封装的突破，公司已完成 2.5D 封装产品线通线，相关产品正在客户送样验证中，整体进展顺利，公司后续会根据客户需求及国产先进制程产能释放节奏进行扩产。

3. 公司整体毛利率持续上升的原因是什么？是源于涨价还是折旧影响减小？今年是否有继续涨价的可能？

毛利率上升主要源于规模效应。上游材料涨价通过顺价方式传导给下游客户，对毛利率影响相对平衡；同时公司产能稼动率维持在较高水平，部分客户也会出于保证产能、缩短交期等目的主动溢价，预计对毛利率有正向贡献。

4. 公司对于端侧 AI 发展前景的看法？

公司坚定看好端侧 AI 市场，公司主要客户均积极布局端侧 AI 产品，随着下游消费电子公司探索硬件落地形式，预计未来增长空间较大。

5. 2.5D 封装行业竞争格局？

在硅转接板方案上，目前部分大陆友商已有成熟量产经验；在硅桥方案上，目前大陆行业内还处于同一起跑线。公司坚定践行技术创新战略，以前瞻性布局切入先进封装领域，基于自有的 Chiplet 技术推出了 FH-BSAP（Forehope-Brick-Style Advanced Package）积木式先进封装技术平台。涵盖 RWLP 系列（晶圆级重构封装，Fan-out 扇出封装）、HCOS 系列（2.5D 晶圆级/基板上异构封装）、Vertical 系列（晶圆级垂直芯片堆栈封装）等，精准适配 Fan-out（FO）、2.5D/3D 先进晶圆级封装等多元化先进封装技术需求。目前公司已完成 2.5D 封装产线通线，相关产品正在客户送样验证中，整体进展顺利。

6. 2.5D 产能规划情况？

公司前期已经发布了可转债的募集说明书，募投项目规划的相关产能为 5000 片/月，后续会根据客户需求及国产先进制程产能释放节奏进行扩产。

7. 2026 年公司资本开支规划？

2026 年资本开支规划约 40 亿元，主要投向成熟封装扩产、先进封装产品线等。

8. Bumping 现有产能情况及扩产规划？

	<p>目前产能约 3 万片，计划年底提升至 4.5 万片左右。</p> <p>9. 公司未来再融资规划？</p> <p>公司资本运作请以后续公告为准。</p> <p>10. 公司车规类产品主要有哪些？</p> <p>车规领域以车载 CIS、激光雷达、MCU 等产品为主。</p> <p>11. 公司对于 PA 产品的规划？</p> <p>目前公司在 PA 产品方面整体控制产能节奏，后续重心以高端模组类产品为主。</p> <p>12. 2026 年二期产能释放进度预期如何？</p> <p>二期产能将持续爬坡，预计营业收入将保持逐季增长。</p> <p>13. 可转债即将重新触发赎回，公司后续有何打算？是否会选择赎回？</p> <p>甬矽转债将于 4 月 28 日为首个交易日重新计算，公司股票需满足未来 30 个交易日中有 15 个交易日收盘价不低于转股价 130% 才能触发赎回，请关注后续公告。</p> <p>14. 二期产能今年利用率预计达到多少？</p> <p>成熟封装产能稼动率保持高位；晶圆级封装产能稼动率持续爬坡；2.5D 先进封装正与客户验证中。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 4 月 22 日

注:公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。